

中信证券股份有限公司
关于龙芯中科技术股份有限公司
2023 年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“龙芯中科”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2023 年 12 月 4 日、2024 年 5 月 13 日、2024 年 5 月 14 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制自我评价报告、2023 年度内部控制鉴证报告等文件；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2023 年度审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明；

(4) 查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

(5) 对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

(一) 业绩大幅下滑或亏损的风险

集成电路设计企业的经营业绩受下游市场波动影响较大。如果公司不能及时提供满足市场需求的产品和服务，或下游市场需求发生重大不利变化，公司可能面临业绩下滑的风险。

政策性相关业务受相关政策及市场波动影响较大，当需求大幅降低或延后时，公司将面临业绩大幅下滑或亏损的风险。

(二) 核心竞争力风险

核心技术是公司的核心竞争力，公司存在由于核心技术人员流失、专利保护措施不力等原因导致的核心技术泄密或被他人盗用的风险。如果公司未能持续加强对技术人才的培养、激励和保护力度，公司将面临技术人才流失的风险。随着产品制程工艺和复杂程度的不断提高，公司的流片费用大幅上涨，投入的人力、物力亦将随之增加。如果未能把握好投入节奏，亦或产品开发失败，将为公司带

来经营业绩下滑的风险。

（三）供应商集中的风险

公司经营主要采用 **Fabless** 模式。公司主要负责芯片的设计工作，生产性采购主要包括芯片加工服务及电子元器件等原材料采购。报告期内公司主力芯片产品的加工服务主要供应商，采购金额占比较高。未来若国际政治经济局势剧烈变动或供应商产能紧张加剧，芯片加工服务的供应可能无法满足公司需求，公司将面临采购价格上涨或供货周期延长的风险，对公司生产经营产生一定的不利影响。

（四）应收账款导致的坏账风险

公司报告期末的应收账款规模较大，加大了公司的经营风险。如果宏观经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，公司可能面临应收账款回收困难的风险。

（五）存货跌价风险

公司根据已有客户订单需求以及对市场未来需求的预测制定采购和生产计划。报告期期末，公司存货账面价值较去年同期有所增加，对公司流动资金占用较大。公司可能面临因市场环境发生变化可能出现的存货跌价减值的风险。

（六）研发投入相关的风险

作为技术密集型企业，公司坚持核心技术自主创新的发展战略，报告期内研发投入金额较高，部分研发投入形成了开发支出，后续将转入无形资产。若公司研究成果的产业化应用不及预期，可能对公司的经营产生不利影响。

（七）政府补助变化的风险

集成电路设计产业受到国家产业政策的鼓励和支持。报告期内，公司计入当期收益的政府补助金额对当期利润影响较大。如果公司未来不能持续获得政府补助或政府补助显著降低，则可能会对公司盈利产生一定的不利影响。

（八）市场竞争风险

公司致力于打造独立于 Wintel 体系与 AA 体系的自主生态体系，可能引起竞争对手的高度重视，使得行业竞争加剧。公司面临市场竞争加剧的风险。

公司基于信息系统和工控系统两条主线开展产业生态建设，产品主要销售于关键信息基础设施自主化领域。在全球计算机领域，CPU 商用市场基本被 Intel、AMD 两家占据，面对龙头企业带来的竞争压力，公司可能在激烈的行业竞争中处于不利地位。

（九）宏观环境风险

美国不断出台针对中国高科技半导体企业的出口管制政策，经济全球化受到较大挑战，对全球半导体市场和芯片供应链稳定带来不确定风险。可能对公司的生产经营造成不利影响。

（十）知识产权纠纷的风险

公司所从事的处理器及配套芯片设计业务涉及大量的知识产权及各种知识产权相关的许可、授权、转让等。其通常较为复杂，涉及境内、外多个法域，适用范围、使用方式、可执行性甚至有效性都可能遇到法律挑战，其中一些可能会演变为诉讼、仲裁、调查、制裁、保全措施等法律程序。在涉及该等法律程序时，公司有可能因此而支出高额法律费用开支。更进一步的，由于该等法律程序通常涉及境内外多个法域，时间周期较长，亦有可能被各种法律或法律之外的因素所影响，当该等法律程序的最终结果对公司不利时，则有可能导致公司面临向对方或与该等知识产权有关的第三方支付违约金、知识产权授权费用、损害赔偿、罚金等，也有可能导致公司的知识产权或相关权利、授权被宣告无效或撤销，还有可能对公司的名誉造成影响。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	50,569.44	73,865.79	-31.54
归属于上市公司股东的净利润	-32,943.98	5,175.20	-736.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,186.01	-15,677.78	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-41,032.74	-76,904.62	不适用
主要会计数据	2023年	2022年	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	354,892.49	389,052.08	-8.78
总资产	411,208.90	436,834.08	-5.87
主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.82	0.14	-685.71
稀释每股收益(元/股)	-0.82	0.14	-685.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.10	-0.41	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.84	1.96	减少10.80个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-11.85	-5.93	减少5.92个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	103.47	53.83	增加49.64个百分点

报告期内，公司实现营业收入 50,569.44 万元，较上年下降 31.54%；实现归属于上市公司股东的净利润-32,943.98 万元，较上年下降 736.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-44,186.01 万元，较上年减少 -28,508.23 万元。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-41,032.74 万元。

报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产为 354,892.49 万元，较年初下降 8.78%；总资产为 411,208.90 万元，较年初下降 5.87%。

报告期内，基本每股收益和稀释每股收益为-0.82 元，较上年同期下降 685.71%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为-1.10 元；加权平均净资产收

益率为-8.84%，较上年同期减少 10.80 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-11.85%，较上年同期下降 5.92 个百分点；研发投入占营业收入的比例为 103.47%，较上年同期增加 49.64 个百分点。

上述主要会计数据和财务指标的增减变动，主要原因如下：

1、报告期内，公司受宏观经济环境、行业周期变化、电子政务市场处于调整期导致采购量减少以及传统优势工控领域部分重要客户内部管理事宜导致采购暂时停滞的影响，公司的信息化类芯片和工控类芯片的营业收入较上年均出现下降；

2、报告期内，由于信息化类芯片销量的下降带来单颗产品固定成本分摊额的增加，同时公司为拓展市场份额，部分产品价格承压，以上双重因素叠加导致报告期内毛利率较上年下降 11.03 个百分点；

3、报告期内，公司持续加大研发投入，积极拓展市场，叠加知识产权诉讼和仲裁的影响，导致期间费用较上年有所增长，其中研发费用同比增长 35.68%。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

1、长期坚持自主研发形成的技术和能力积累

龙芯中科是国内唯一坚持基于自主指令系统构建独立于 Wintel 体系和 AA 体系的开放性信息技术体系和产业生态的 CPU 企业。经过长期积累，形成了自主 CPU 研发和软件生态建设的体系化关键核心技术积累。

与国内多数集成电路设计企业购买商业 IP 进行芯片设计不同，龙芯中科坚持自主研发核心 IP，形成了包括系列化 CPU IP 核、GPU IP 核、内存控制器及 PHY、高速总线控制器及 PHY 等上百种 IP 核。

与国内多数 CPU 企业主要基于 ARM 或者 X86 指令系统融入已有的国外信息技术体系不同，龙芯中科推出了自主指令系统 LA，并基于 LA 迁移或研发了操作系统的核心模块，包括内核、三大编译器（GCC、LLVM、GoLang）、三大虚拟机（Java、JavaScript、.NET）、浏览器、媒体播放器、KVM 虚拟机等。

形成了面向服务器、面向桌面和面向工控类应用的基础版操作系统。

与国内多数 CPU 设计企业主要依靠先进工艺提升性能不同，龙芯中科通过设计优化和先进工艺提升性能，摆脱对最先进工艺的依赖。通过自主设计 IP 核，克服境内工艺 IP 核不足的短板。

上述在长期自主研发和产业化过程中形成的核心技术和能力积累使得龙芯中科可以在现有技术基础上形成快速升级迭代，可以更好地满足客户定制化基础软硬件需求，可以更好地建设自主信息产业生态。

2、产业生态优势明显

龙芯中科坚持走自主创新与生态建设路线。公司经过持续积累形成自主指令系统架构 LA，自主研发了包括处理器核心在内的上百种核心模块，取得了 500 多项发明专利。龙芯中科是国内 CPU 企业中极个别可以进行指令系统架构及 CPU IP 核授权的企业，是极个别在股权结构方面保持开放、未被整机厂商控制的企业。为扩大龙架构的生态，2023 年开始龙芯中科将龙芯 CPU 核心 IP 开放授权给部分合作伙伴，支持合作伙伴研制基于龙芯 CPU 核心 IP 及龙架构指令系统的 SoC 芯片产品。目前，与公司开展合作的厂商达到数千家，下游开发人员达到数十万人，基于龙芯处理器的自主信息产业生态体系正在逐步形成。

3、团队优势

龙芯中科长期坚持“又红又专，红重于专”的人才选用和培养标准，在长期发展过程中锻造了一支有灵魂、有战斗力、能啃硬骨头的团队。龙芯团队坚持为人民做龙芯的根本宗旨，坚持自力更生、艰苦奋斗的工作作风，坚持实事求是的思想方法。在长期的研发和产业化实践中，团队在处理器研发、基础软件研发、结合客户需求的定制化开发等方面形成了深厚的技术积累。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	42,456.23	31,290.40	35.68
资本化研发投入	9,865.96	8,471.28	16.46
研发投入合计	52,322.19	39,761.67	31.59
研发投入总额占营业收入比例 (%)	103.47	53.83	增加 49.64 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	18.86	21.31	减少 2.45 个百分点

报告期内，公司持续保持研发投入。其中核心技术方面，在处理器核、图形处理器、高速接口 IP 核方面都有持续进展；芯片研发方面，高性能四核通用处理器 3A6000 芯片流片成功，其他如服务器芯片、SoC 芯片、嵌入式及专用芯片等都按进度正常进行或完成；系统软件方面，进一步加强基础软件和解决方案的研发投入，不断完善软件生态。

报告期内，研发投入资本化的比重未出现大幅变动。

（二）研发进展

1、在研项目情况

截至 2023 年末，公司在研项目的具体进展如下：

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额 (万元)	累计投入金额 (万元)	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	芯片研发项目 A	不适用	4,824.71	19,993.90	完成 32 核产品的产品化，已正式推向市场	面向服务器市场的高性能多核处理器芯片产品	国内先进水平	数据中心、云计算以及高性能计算等领域
2	芯片研发项目 B	不适用	2,522.78	3,880.25	完成多款工控 SoC 芯片产品的初样验证，进行产品化工作，同时进行终端应用 SoC 芯片的研制	面向工控和终端市场的 SoC 芯片产品，集成 2 个处理器核，集成 PCIE3.0、SATA3.0、USB3.0 等接口，集成自研 3DGPU 以及 GMAC 接口和其他常用接口	国内先进水平	工业控制与终端等领域
3	芯片研发项目 C	不适用	66.45	1,210.41	完成新款桥片的产品化	适配龙芯系列处理器芯片，集成自研 GPU，及丰富的外围接口	国内先进水平	龙芯 3 号系列处理器配套桥片
4	芯片研发项目 D	不适用	842.35	2,490.56	时钟芯片和 LDO 电源芯	适配龙芯 CPU 的模拟	国内先进	龙芯 CPU 配套

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额 (万元)	累计投入金额 (万元)	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					片都达到小批量应用，DCDC 电源芯片进行产品验证	芯片	水平	模拟芯片，和 CPU 一起，提供全套自主可控解决方案，应用于服务器、桌面、工控等领域
5	芯片研发项目 E	不适用	4,628.43	7,232.68	完成新一代产品的流片及初样验证并对外发布	面向桌面和服务器市场的高性能处理器芯片产品	国内先进水平	桌面、笔记本、服务器等领域
6	芯片研发项目 F	不适用	1,210.26	8,885.18	完成初样验证及正样产品化	面向桌面、笔记本市场的高性价比多核处理器芯片产品	国内先进水平	桌面、笔记本等领域
7	芯片研发项目 G	不适用	770.89	1,679.45	完成流片及初样验证并对外发布	面向工控市场的 SoC 芯片产品，集成 1 个或多个低功耗嵌入式处理器核，集成多种工业控制接口	国内先进水平	工业控制
8	芯片研发项目 H	不适用	875.49	1,639.24	完成门锁应用芯片的初样、正样验证等产品化工作；同时结合行业应用完成针对电机应用升级款芯	结合市场应用，推出国内领先水平的 MCU 产品	国内先进水平	智能家居、五金电子等领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额 (万元)	累计投入金额 (万元)	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					片设计并交付流片，完成新款流量表芯片产品的研制及流片成功			
9	芯片研发项目 I	不适用	1,990.87	1,990.87	完成新一代 16 核产品的结构设计优化并交付流片	面向服务器市场的高性能多核处理器芯片产品，在原有服务器芯片基础上改进片间互连，提升接口速率，提高处理器性能 50% 以上	国内先进水平	数据中心、云计算以及高性能计算等领域
10	关键核心技术研发项目 A	不适用	5,673.63	9,025.26	完成研制，达到设计目标	更高性能处理核 IP，相同工艺下，性能较上一代大幅提升	国内先进水平	集成至龙芯系列处理器中，可应用于桌面 PC、服务器等领域
11	关键核心技术研发项目 B	不适用	3,458.93	8,549.07	完成第一代技术优化，正在进行第二代技术研发，已完成结构设计和硅前仿真验证	满足图形处理和通用计算的要求	国内先进水平	集成至龙芯桥片或处理器中，提升系统图形处理能力
12	关键核心技术研发项目 C	不适用	2,953.15	5,644.71	片间互连及多品类的高速接口设计完成，并进行流	持续提高高速接口物理层传输速率，提高	国内先进水平	用于各类芯片间或芯片内互

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额 (万元)	累计投入金额 (万元)	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					片验证	芯片间数据收发速度，并逐步拓展高速接口协议兼容性		连
13	关键核心技术研发项目 D	不适用	322.90	3,409.17	完成研制，达到设计目标	进一步提高中高端处理器核的性能，与市场主流同类型处理器核可比，给公司芯片产品提供核心竞争力支持	国内先进水平	集成至龙芯系列处理器中，可应用于中高端工控、桌面 PC 等领域
14	关键核心技术研发项目 E	不适用	23.34	23.34	启动新一代处理器核研发工作，将重点优化核的能效	进一步提高中高端处理器核的能效，重点在功耗的优化，达到市场同类型处理器核主流水平，给公司芯片产品提供核心竞争力支持	国内先进水平	集成至龙芯系列处理器中，可应用于中高端工控、笔记本电脑、云终端等领域
15	关键核心技术研发项目 F	不适用	0.21	0.21	启动研制工作，开展协议分析调研工作	实现高性能、低功耗、高稳定性及良好扩展性的 DDR5 内存控制器，以满足未来计算需求	国内先进水平	用于通用处理器和内存之间的互连

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额 (万元)	累计投入金额 (万元)	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
16	关键核心技术研发项目 G	不适用	155.00	155.00	结合新一代处理器的需求,启动对下一代高性能处理器核的优化研制工作	实现更高性能处理核 IP,关注 IP 核的执行效率,在相同工艺下,性能较上一代进一步提升	国内先进水平	集成至龙芯系列处理器中,可应用于桌面 PC、服务器等领域
17	封装与测试技术研发	不适用	894.48	2,937.64	具备通用处理器的中测成测能力,并持续改进芯片良率	建立高性能芯片的封装测试实验平台	国内先进水平	高性能多核芯片封装
18	操作系统基础软件研发	不适用	11,288.48	29,876.85	在国际开源软件界,LoongArch 架构已成为与 X86、ARM 并列的开源软件世界顶层指令集架构。Linux 内核、GCC 编译工具链、LLVM 编译器、Go 语言、Rust 语言、QEMU 系统、V8JavaScript 引擎、.NET 编程框架、FFmpeg 音视频编解码加速库等大量重要的开源软件社区都已经以较高级别和较完善的程度实现对 LoongArch 架构的支持。	完成对新研芯片的系统软件支持。在多个国际开源软件社区实现对 LoongArch 架构的支持。研制应用二进制兼容系统实现跨操作系统发行版的应用软件二进制兼容。研制打印驱动引擎实现对 Linux 平台打印机的支持	国内领先水平,部分达到国际领先水平	桌面办公、服务器、嵌入式、物联网、云计算、大数据等领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额 (万元)	累计投入金额 (万元)	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					基于这些开源软件社区所发布的软件版本，可以直接构建出 LoongArch 架构的操作系统发行版。龙芯打印驱动引擎实现了对 XPS 打印框架和 CAPT 协议的兼容，支持超过 6300 多款型号。二进制翻译系统、兼容存量 web 应用的浏览器解决方案等产品功能、性能得到进一步完善			
19	3 号系列解决方案研发	不适用	5,416.93	17,114.11	研制了 5000 系列及 3A6000 等多款面向 PC/服务器等解决方案，部分产品已达到批量出货状态	基于龙芯系列芯片，开发面向终端和服务器的产品解决方案，其中终端类包括笔记本、台式机、一体机、云终端、自助机具等产品方案，服务器包括单、双、四路等低中高产品方案	国内先进水平	桌面与服务器类应用

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额 (万元)	累计投入金额 (万元)	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
20	2号系列解决方案研发	不适用	3,173.69	6,745.21	基于龙芯系列 SoC 芯片，根据应用场景需求，研发不同规格、功能的产品和解决方案，包括基于 2K2000、2K1500、2P500 等多款芯片的如 NUC、笔记本电脑、打印机控制板等多种解决方案，部分项目处于验证、测试阶段，部分项目已实现了量产或小批量出货状态	基于龙芯系列 SoC 芯片，研发不同规格、功耗、应用场景的开发板或核心模块	国内先进水平	工业控制、电力、显控终端、边缘计算、云终端等领域
21	1号系列解决方案研发	不适用	774.29	3,462.48	研制多款基于 MCU 芯片的解决方案，包括电机驱动、超声波、智能门锁等领域的解决方案，部分项目处于算法优化、验证、测试、产品化阶段，部分项目已实现量产或小批量出货状态	基于龙芯 MCU 芯片，开发具备高可靠性、高安全性、高扩展性行业解决方案，同时为合作伙伴提供相应的开发、测试工具，提高合作伙伴的行业竞争力	国内先进水平	智能门锁、智能表计、智能家居、智能出行、电动工具等行业
22	教学实验箱解决方案研发	不适用	454.91	998.36	完成多款龙芯 IP 和龙芯芯片的教学实验设备的产品化，与高校合作完成多	基于龙芯芯片或者龙芯 IP 开发多款面向不同课程的计算机类课	国内先进水平	高校、职校计算机类课程实验教学

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额 (万元)	累计投入金额 (万元)	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					门计算机核心课程，正在 高校进行试点教学	程教学实验设备		
合计	/		52,322.19	136,943.95	/	/	/	/

2、知识产权

公司在各核心技术领域积极进行知识产权布局，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已获授权专利 690 个，其中发明专利 546 个，实用新型专利 143 个，外观设计专利 1 个。此外，公司还拥有软件著作权 175 个，集成电路布图设计专有权 22 个。

报告期内获得的知识产权列表如下所示：

知识产权类型	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	139	85	933	546
实用新型专利	27	20	186	143
外观设计专利	1	0	2	1
软件著作权	26	22	179	175
其他	7	6	34	22
合计	200	133	1334	887

注：表格中的“其他”是指集成电路布图设计

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，募集资金进度与原计划基本一致，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况如下：

2023 年度，公司控股股东、实际控制人未发生减持行为。2023 年度，公司控股股东北京天童芯源科技有限公司（以下简称“天童芯源”）通过上海证券交易所集中竞价交易方式合计增持 96,580 股，截至 2023 年 12 月 31 日，天童芯源持有公司的股份数量为 86,413,978 股，占公司总股份的 21.55%。

2023 年度，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在持股变动情况。截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结的情形。

十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

2023 年度，公司营业收入为 50,569.44 万元，较上年下降 31.54%，主要系公司受宏观经济环境、行业周期变化、电子政务市场处于调整期导致采购量减少以及传统优势工控领域部分重要客户内部管理事宜导致采购暂时停滞的影响所致。归属于上市公司股东的净利润为-32,943.98 万元，较上年下降 736.57%，由盈转亏，主要原因为：1、营业收入出现下降；2、信息化类芯片销量的下降带来单颗产品固定成本分摊额的增加，同时公司为拓展市场份额，部分产品价格承压，以上双重因素叠加导致毛利率较上年下降 11.03 个百分点；3、公司持续加大研发投入，积极拓展市场，叠加知识产权诉讼和仲裁的影响，导致期间费用较上年有所增长所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-44,186.01 万元，上年为-15,677.78 万元。

保荐人已在本报告之“三、重大风险事项”之“（一）业绩大幅下滑或亏损的风险”对相关风险进行提示。未来，保荐人将督促公司做好信息披露工作，及时、充分地揭示经营风险，切实保护投资者利益，亦提醒投资者特别关注行业周期波动及市场环境变化带来的投资风险。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于龙芯中科技术股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人:



陈熙颖



何洋

